

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
1. Dezember 2005 (01.12.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/115072 A2

(51) Internationale Patentklassifikation?: H05K 13/00

[DE/DE]; Dachgred 31, 93152 Nittendorf (DE). BE-MMERL, Thomas [DE/DE]; Am Gsteinert 3, 92421 Schwandorf (DE). FÜRGUT, Edward [DE/DE]; Ligusterweg 2, 86453 Dasing (DE). JEREVIC, Simon [SI/DE]; Hermann-Köhl-Str. 14, 93049 Regensburg (DE). VILSMEIER, Hermann [DE/DE]; Flößerstr. 14, 93059 Regensburg (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2005/000892

(74) Anwalt: SCHÄFER, Horst; c/o Kanzlei Schweiger &

(22) Internationales Anmeldedatum:
17. Mai 2005 (17.05.2005)

Partner, Karl-Theodor-Str. 69, 80803 München (DE).

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA,
MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

{Fortsetzung auf der nächsten Seite}

(30) Angaben zur Priorität:
10 2004 025 279.3 19. Mai 2004 (19.05.2004) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-
Martin-Str. 53, 81669 München (DE).

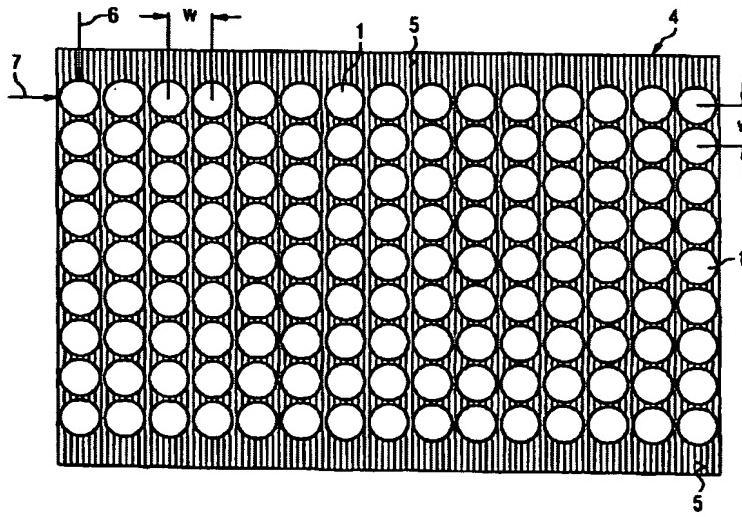
(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BAUER, Michael

BEST AVAILABLE COPY

(54) Title: SUPPORT WITH SOLDER GLOBULE ELEMENTS AND A METHOD FOR ASSEMBLY OF SUBSTRATES WITH
GLOBULE CONTACTS

(54) Bezeichnung: TRÄGER MIT LOTKUGELEMENTEN UND EIN VERFAHREN ZUM BESTÜCKEN VON SUBSTRA-
TEN MIT KUGELKONTAKTEN



(57) Abstract: The invention relates to a support (4) with solder globule elements (1), for assembly of substrates (2) with globule contacts. The invention further relates to a unit for assembly of substrates (2) with globule contacts and a method for assembly of substrates (2) with globular contacts. The support (4) comprises an adhesive layer (5) applied to one side thereof, whereby said adhesive layer (5) largely loses the adhesive force thereof on irradiation. The support (4) further comprises solder globule elements (1), tightly packed in rows (6) and columns (7) on the adhesive layer (5) at given separations (w) for a semiconductor chip or a semiconductor component.

{Fortsetzung auf der nächsten Seite}

WO 2005/115072 A2